

BGA (EDS)

개요

OVERVIEW

IC 및 수동소자를 내장하는 Module용 기판

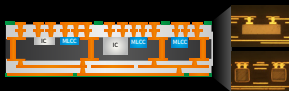
- Module 사이즈 감소 및 최단 Path 연결로 Noise 개선 가능
- 응용 분야 : Mobile Power Module, 전장용 등



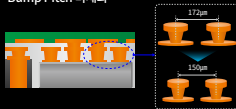
차별화

DIFFERENTIATION

Multi-Die/Multi-Passive Integration 가능



Bump Pitch 미세화



주요 사양

KEY SPECIFICATIONS

	Chip Thickness	100µm
	Chip / PKG Ratio	Max. 50%
Substrate	Bump Pitch	172µm
	Via Size	65µm